PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-220668

(43) Date of publication of application: 09.08.2002

(51)Int.CI.

C23C 16/26 H01L 21/312

(21)Application number: 2001-341576

.....

(71)Applicant: DAIKIN IND LTD

(22)Date of filing:

07.11.2001

(72)Inventor: NAKAMURA SHINGO

ITANO MITSUSHI

AOYAMA HIROICHI

(30)Priority

Priority number: 2000341109

Priority date : 08.11.2000

Priority country: JP

(54) FILM FORMING GAS AND PLASMA FILM-FORMING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To form an insulating interlayer consisting of a fluorocarbon polymer film of which the film density is controlled.

SOLUTION: This film forming gas has 1 or more double bonds or one triple bond, and this plasma film-forming method includes using the film forming gas.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-220668 (P2002-220668A)

(43)公開日 平成14年8月9日(2002.8.9)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

C 2 3 C 16/26 H01L 21/312 C 2 3 C 16/26

4K030

H01L 21/312

A 5F058

審査請求 未請求 請求項の数22 OL (全 9 頁)

(21)出顧番号

特顧2001-341576(P2001-341576)

(22)出願日

平成13年11月7日(2001.11.7)

(31)優先権主張番号 特願2000-341109(P2000-341109)

(32)優先日

平成12年11月8日(2000.11.8)

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出顧人 000002853

ダイキン工業株式会社

大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号

梅田センタービル

(72)発明者 中村 新吾

大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン

工業株式会社淀川製作所内

(72)発明者 板野 充司

大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン

工業株式会社淀川製作所内

(74)代理人 100065215

弁理士 三枝 英二 (外6名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 成膜ガスおよびプラズマ成膜方法

(57)【要約】

【課題】膜密度を制御してフルオロカーボンポリマー膜 からなる層間絶縁膜を形成する。

【解決手段】二重結合を1以上、または三重結合を1つ 有する成膜ガスおよび該成膜ガスを用いたプラズマ成膜 方法

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式(1):

Rfh=CXY (1)

(RfhはCF, CF、CF, CHまたはCF, を示し、XおよびYは、同一又は異なってF,C1,Br,I,HまたはC, F, H、(a=1-4、b=0-9,c=0-9, b+c=2a+1)を示す。) で表される少なくとも 1 種以上のガスを含む成膜ガス。

【請求項2】一般式(2):

 $Rf = C(C_4 F_{2d+1}) (C_6 F_{2e+1})$ (2)

(RfはCF, CFあるいはCF $_{\rm z}$ 、d, eは同一又は異なって $_{\rm 0}$ 、 $_{\rm 1}$ 、2または $_{\rm 3}$ を示す。 $_{\rm 0+e<5}$)で表される化合物からなる群から選ばれる少なくとも $_{\rm 1}$ 種以上のガスを含む請求項 $_{\rm 1}$ に記載の成膜ガス。

【請求項3】 $CF_1CF_2CFCF_1$ 、 $CF_1CF_2CF_2CF_3$ 及び $CF_1CF_2CF_3$ (CF_1) CF_2 からなる群から選ばれる少なくとも 1 種を含む請求項2 に記載の成膜ガス。

【請求項4】二重結合を二つ有する一般式(3):

 $C_F F_a H_a (3)$

(f=4-7、g=1-12、h=0-11、g+h=2f-2を示す。) で表される化合物を少なくとも 1 種含む成膜ガス。

【請求項5】(1)(1) パーフロロメチル基CF3-を有しない二重結合を二つ持つ化合物(CF₂=CFCF=CF₂ 、CF₂=CF CF₂CF=CF₃ 、CF₂=CFCF₃ CF₃ CF=CF₄):

- (2) 二重結合に直接結合したCF, CF部分と二重結合二つ 持つ化合物 (CF, CF=CFCF=CF, 、CF, CF=CFCF, 、CF, CF=CFCF, 、CF, CF=C(CF,);
- (3) 主鎖から分岐したパーフロロメチル基CF, -を有する 二重結合を二つ持つ化合物(CF, =C(CF,)CF=CF, 、CF, =C (CF,)C(CF,)=CF, 、CF, =CFCF(CF,)CF=CF, 、CF, =CFCF, C(CF,)=CF, 、CF, =CFCF=C(CF,),); 及び
- (4) パーフロロメチル基CF, よりも大きい基(C, H, n, 1-; n>1)を有する二重結合を二つ持つ化合物(CF, CF, CF=CFC F=CF, CF, =C(CF, CF,) からなる群から選ばれる少なくとも1種以上のガスを含む請求項4に記載の成膜ガス。

【請求項6】一般式(4):

CF, C≡CZ (4)

(ZはF, I, HまたはC, F, H, (i=1-4、j=0-9、k=0-9、j+k=2i+1)を示す。) で表される化合物を少なくとも1種以上のガスを含む成膜ガス。

【請求項7】 $CF_1C=CCF_1$, $CF_2C=CF_2CF_3$ C= CCF_2CF_3 からなる群から選ばれる少なくとも 1 種のガスを含む請求項6 に記載の成膜ガス。

【請求項8】請求項1~3のいずれかに記載のガスの少なくとも1種と請求項4または5に記載のガスの少なくとも1種を含む成膜ガス。

【請求項9】請求項1~3のいずれかに記載のガスの少なくとも1種と請求項6または7に記載のガスの少なくとも1種を含む成膜ガス。

【請求項10】請求項4または5に記載のガスの少なく 50 を成膜することを特徴とするプラズマ成膜方法。

とも1種と請求項6または7に記載のガスの少なくとも 1種を含む成膜ガス。

【請求項11】c-C, F, CF, CF, CF, CF, =CFCF=CF, 、c-C, F, からなる群から選ばれる少なくとも1種をさらに含む請求項 $1\sim3$ のいずれかに記載の成膜ガス。

【請求項12】c-C₄F₈、CF3CF=CF₂、CF2=CFCF=CF₂、c-C 5F₈からなる群から選ばれる少なくとも1種をさらに含む請求項 $4\sim5$ のいずれかに記載の成膜ガス。

【請求項13】 c-C, F₈、CF, CF=CF₂、CF₂=CFCF=CF₂、 c-C 10 、F₈からなる群から選ばれる少なくとも1種をさらに含む請求項 $6\sim7$ のいずれかに記載の成膜ガス。

【請求項 1 4 】 c-C, F, CF, CF, CF, CF, =CFCF=CF, 、 c-C , F, 、 CF, CF=CFCF=CF, 、 CF, CF=CFCF, 、 CF, C≡ CF, からな る少なくとも 1 種以上のガスを含む成膜ガス。

【請求項15】CF₁=CFCF=CF₁、CF₁CF=CFCF=CF₂、CF₃CF=CF₄、CF₃CF=CF₄からなる少なくとも1種以上のガスを含む成膜ガス。

【請求項16】さらに希ガス、不活性ガス、NH,、H,、 炭化水素、Q、含酸素化合物、ハロゲン化合物、HFC(Hy 20 drofluorocarbon)及び、単結合及び二重結合を持つPFC (perfluorocarbon)ガスからなる群から選ばれる少なく とも1種を含む請求項1~13のいずれかに記載の成膜 ガス。

【請求項17】さらにHe、Ne、Ar、Xe、Krからなる群か ら選ばれる希ガス、Ngからなる不活性ガス、NHg、Hg、C H、C、H、C、H、C、H、C、H、などからなる炭化水素、 O, CO, CO, (CF,), C=O, CF, CFOCF, CF, OCF, などから なる含酸素化合物、CF, I、CF, CF, I、(CF,), CFI、CF, CF, CF, I, CF, Br, CF, CF, Br, (CF,), CFBr, CF, CF, CF, CF, CF 30 ₃C1、CF₃CF₂C1、(CF₃)₂CFC1、CF₃CF₂CF₂C1、CF₂≃CFI、C Fz=CFC1、CFz=CFBr、CFz=CIz、CFz=CC1z、CFz=CBrzなど からなるハロゲン化合物、CH, F, 、CHF, 、CHF, 、CF, CH F2 CHF2 CHF2 CF3 CF3 CF4 F7 CHF2 CF4 F7 CF3 CF3 CF4 CF4 FCH ¿F、CF2=CHF、CHF=CHF、CH4=CF2、CH4=CHF、CF3CH=CF2、 CF。CH=CH、CH。CF=CH。などからなるHFC(Hydrofluorocar bon)及び、CF₂ =CF₂ , CF₄ , C₄ F₅ , C₄ F₈ , C₄ F₁₀ 、c-C₄ F₈ , c-C, F。などからなる単結合及び二重結合を持つPFC(perf Tuorocarbon)ガスからなる群から選ばれる少なくとも 1 種のガスを含む請求項1~13のいずれかに記載の成膜 40 ガス。

【請求項18】請求項1~15のいずれかに記載の成膜 ガスのガスプラズマで、フルオロカーボンポリマー膜を 成膜することを特徴とするプラズマ成膜方法。

【請求項19】請求項1~15のいずれかに記載の成膜 ガスのガスプラズマで、フルオロカーボンボリマー膜の 密度を調整して成膜することを特徴とするプラズマ成膜 方法。

【請求項20】請求項16~17のいずれかに記載の成 膜ガスのガスプラズマで、フルオロカーボンポリマー膜 を成瞭することを特徴とするプラズマ成膜方法。

【請求項21】請求項16~17のいずれかに記載の成 膜ガスのガスプラズマで、フルオロカーボンポリマー膜 の密度を調整して成膜することを特徴とするプラズマ成 膜方法。

3

【請求項22】請求項18~21のいずれかに記載のプラズマ成膜方法により得ることができるフルオロカーボンポリマー膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体デバイスの 10 層間絶縁膜、有機ELデバイスおよびバイオセンサーデバイスのセンサーの保護膜などに使用することができるフルオロカーボンボリマー膜をプラズマ処理することにより形成するための成膜ガス及びプラズマ成膜方法に関する。

[0002]

【従来の技術及びその課題】半導体デバイスの微細化とともに、多層配線技術が重要になってきた。その多層配線構造においては、あるメタル配線と別のメタル配線を分離する層間絶縁膜と呼ばれる膜が使用される。近年で20はデバイスの高速化のために、配線構造におけるRC遅延要素の低減が求められている。メタル配線の抵抗を低減するためにAI配線からCu配線への変更が進み、層間絶縁膜では、配線間および層間の容量を減らすため、10w-k膜とよばれる比誘電率の低い絶縁材料が導入され始めた。

【0003】従来、層間絶縁膜としてSiQが使用されてきたが、比誘電率は4.0と高い。デザインルール0.18μm以下のデバイスでは、SiQではCu配線の利点を生かせないため、層間絶縁膜として低誘電率(10w-k)膜を導入することは必須となる。フルオロカーボンポリマー膜は比誘電率2.5前後と低く、次世代の層間絶縁膜の材料のひとつとして有望である。しかし、従来の成膜ガスは温室効果が高く、地球環境に与える影響が大きかった。

[0004] また、これらのフルオロカーボンボリマー 膜は、半導体デバイスの層間絶縁膜に限らず、有機EL デバイス、バイオセンサーデバイス、マイクロマシンなどの保護膜としても使用できる。この保護膜は前述の用途以外にも、撥水性、撥油性、透明性、低誘電率などフッ素系ポリマーの特性を必要とする部位に使用できる。 [0005] 本発明は、地球温暖化の影響が非常に小さい成膜ガスをブラズマ処理して、膜密度を制御してフルオロカーボンポリマー膜からなる層間絶縁膜および多種のデバイスや機械部品の保護膜などを形成することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、半導体デバイスの層間絶縁膜、有機ELデバイス、バイオセンサーデバイス、マイクロマシンなどの保護膜ほかに使用するととができるフルオロカーボンボリマー障をプラズマ処理

することにより形成するための成膜ガス及びプラズマ成 膜方法を提供するものである。

項1. 一般式(1):

Rfh=CXY (1)

(RfhはCF, CF, CF, CHまたはCF, を示し、XおよびYは、同一又は異なってF,Cl,Br,I,HまたはC,F,H (a=1-4、b=0-9,c=0-9, b+c=2a+1)を示す。) で表される少なくとも1種以上のガスを含む成膜ガス。

項2. 一般式(2):

 $0 Rf = C(C_a F_{2d+1}) (C_a F_{2d+1})$ (2)

(RfはCF, CFあるいはCF, d, eは同一又は異なって0.

1.2または3を示す。d+e<5)で表される化合物からなる群から選ばれる少なくとも1種以上のガスを含む項1 に記載の成膜ガス。

項3. CF₁CF=CFCF₁、CF₁CF=CFCF₂CF₃及びCF₃CF=C(C F₃)CF₃からなる群から選ばれる少なくとも1種を含む項2に記載の成膜ガス。

項4. 二重結合を二つ有する一般式(3):

GFaH (3)

20 (f=4-7、g=1-12、h=0-11、g+h=2f-2を示す。)で表され る化合物を少なくとも1種含む成膜ガス。

項5. (1) パーフロロメチル基CF₃-を有しない二重結合 を二つ持つ化合物(CF₃=CFCF₂CF₃ CF₄CF₅ CF₅ CF₅ CF₅ CF₅ CF₇ CF₇

- (2) 二重結合に直接結合したCF, CF部分と二重結合二つ 持つ化合物(CF, CF=CFCF=CF, 、CF, CF=CFCF=CFCF, , CF, = CFCF, CF=CFCF, 、CF, CF=C(CF,)CF=CF,);
- (3) 主鎖から分岐したパーフロロメチル基CF₃ -を有する 二重結合を二つ持つ化合物(CF₂ =C(CF₃)CF=CF₂ 、CF₂ =C (CF₃)C(CF₃)=CF₂ 、CF₂ =CFCF₃ (CF₃)=CF₂ 、CF₃ =CFCF₃ C(CF₃)=CF₄ 、CF₄ =CFCF=C(CF₃)₂);及び
- (4) パーフロロメチル基CF, よりも大きい基を有する二 重結合を二つ持つ化合物(CF, CF, CF=CFCF=CF, 、CF $_1$ =C(C F, CF,)CF=CF $_2$)からなる群から選ばれる少なくとも 1 種以上のガスを含む項 4 に記載の成膜ガス。

項6. 一般式(4):

CF₃ C≡CZ (4)

30

(ZはF, I, HまたはGF, H, (i=1-4、j=0-9、k=0-9、j+k=2i+1)を示す。)で表される化合物を少なくとも1種40 以上のガスを含む成膜ガス。

項7. $CF_1C=CCF_1$, $CF_1C=CFD$ $CCF_1CF_2CF_3$ CF_3 CF_3

項8. 項1~3のいずれかに記載のガスの少なくとも 1種と項4または5に記載のガスの少なくとも1種を含む成膜ガス。

項9. 項1~3のいずれかに記載のガスの少なくとも 1種と項6または7に記載のガスの少なくとも1種を含 む成膜ガス。

とができるフルオロカーボンポリマー膜をプラズマ処理 50 項10. 項4または5に記載のガスの少なくとも1種

4

と項6または7に記載のガスの少なくとも1種を含む成 膜ガス。

項11. c-C, F, CF, CF, CF, CF, =CFCF=CF, c-C, F, からなる群から選ばれる少なくとも1種をさらに含む項 1~3のいずれかに記載の成膜ガス。

項12. $C-C_4F_8$ $CF_3CF=CF_2$ $CF_2=CFCF=CF_2$ $C-C_5F_8$ からなる群から選ばれる少なくとも1種をさらに含む項 4~5のいずれかに記載の成膜ガス。

C-C₄ F₈ CF₃ CF=CF₂ CF₂ =CFCF=CF₂ C-C₅ F₈ 項13. からなる群から選ばれる少なくとも1種をさらに含む項 10 6~7のいずれかに記載の成膜ガス。

項14. c-C₄F₈、CF₃CF=CF₂、CF₃=CFCF=CF₂、c-C F₂ CF₂ = CFCF = CF₂ CF₃ CF = CFCF = CF₂ CF₃ CF = CF₂ CF₃ F=CFCF₂からなる少なくとも1種以上のガスをさらに含 む成膜ガス。

項15. CF₂=CFCF=CF₂、CF₃CF=CFCF=CF₂、CF₃CF=C F₁、CF₁CF=CFCF₁からなる少なくとも1種以上のガスを 含む成膜ガス。

さらに希ガス、不活性ガス、NH、、H、、炭化 項16. 水素、O、含酸素化合物、ハロゲン化合物、HFC(Hydrof 20 である。 luorocarbon)及び、単結合及び二重結合を持つPFC(perf luorocarbon)ガスからなる群から選ばれる少なくとも 1 種を含む項1~13のいずれかに記載の成膜ガス。

項17. さらにHe、Ne、Ar、Xe、Krからなる群から選 ばれる希ガス、Naからなる不活性ガス、NHa、Ha、CHa、 C, H。C, H。C, H、C, H、などからなる炭化水素、C, C Q、CO、(CF₁), C=O、CF₁ CFOCF₂、CF₁ OCF₃ などからなる 含酸素化合物、CF, I、CF, CF, I、(CF,), CFI、CF, CF, CF I, CF, Br, CF, CF, Br, (CF,), CFBr, CF, CF, CF, Br, CF, C 1, CF_3CF_2C1 , $(CF_3)_2CFC1$, $CF_3CF_2CF_2C1$, $CF_2=CFI$, $CF_2=30$ =CFC1、CF2=CFBr、CF2=CI2、CF2=CC72、CF2=CBr2などか らなるハロゲン化合物、CH, F, 、CHF, 、CHF, 、CF, CHF, 、 =CHF、CHF=CHF、 CH2 =CF2、 CH2 =CHF、 CF3 CH=CF2、 CF3 CH=C Ӊ、CӉCF=CӉなどからなるHFC(Hydrofluorocarbon)及 U', $CF_2 = CF_2$, CF_4 , C_2F_6 , C_3F_8 , C_4F_{10} , $C-C_4F_8$, $C-C_5F_8$ などからなる単結合及び二重結合を持つPFC(perfluoroc arbon)ガスからなる群から選ばれる少なくとも1種のガ スを含む項1~13のいずれかに記載の成膜ガス。

項18. 項1~15のいずれかに記載の成膜ガスのガ 40 スプラズマで、フルオロカーボンポリマー膜を成膜する ことを特徴とするプラズマ成膜方法。

項1~15のいずれかに記載の成膜ガスのガ スプラズマで、フルオロカーボンポリマー膜の密度を調 整して成膜することを特徴とするプラズマ成膜方法。

項16~17のいずれかに記載の成膜ガスの ガスプラズマで、フルオロカーボンポリマー膜を成膜す ることを特徴とするブラズマ成膜方法。

項21. 項16~17のいずれかに記載の成膜ガスの ガスプラズマで、フルオロカーボンポリマー膜の密度を

調整して成膜することを特徴とするプラズマ成膜方法。 項22. 項18~21のいずれかに記載のプラズマ成 膜方法により得ることができるフルオロカーボンポリマ 一膜。

6

[0007]

【発明の実施の形態】本発明で使用する成膜ガスは、好 ましくは一般式(1):

Rfh=CXY (1)

(RfhはCF, CF、CF, CHまたはCF, を示し、XおよびYは、同 一又は異なってF,C1,Br,I,HまたはC,F,H (a=1-4、b=0-9,c=0-9, b+c=2a+1)を示す。) で表される少なくとも1 種以上のガスを含む成膜ガス、より好ましくは一般式 (2):

 $Rf = C(C_d F_{2d+1}) (C_e F_{2e+1})$ (2) (RfはCF, CFあるいはCF, d, eは同一又は異なって 0, 1, 2または3を示す。d+e<5) で表される化合物から なる群から選ばれる少なくとも1種以上のガスを含む成 膜ガス、特に好ましくはCF, CF=CFCF, 、CF, CF=CFCF, C F,、CF,CF=C(CF,)CF,の少なくとも一種を含む成膜ガス

【0008】さらに、本発明で使用する成膜ガスは、二 重結合を二つ有する一般式(3):

CrF. H. (3)

(f=4-7、g=1-12、h=0-11、g+h=2f-2を示す。) で表され る化合物を少なくとも 1 種含む成膜ガス、好ましくは (1)パーフロロメチル基CF, -を有しない二重結合を二つ 持つ化合物(例えばCF,=CFCF=CF,、CF,=CFCF,CF=CF,, C F, =CFCF, CF, CF=CF,)、(2)二重結合に直接結合したCF, C F部分と二重結合を二つ持つ化合物(例えば、CF, CF=CFC F=CF₂ 、 CF₃ CF=CFCF=CFCF₃ , CF₂ =CFCF₂ CF=CFCF₃ 、 CF₃ CF= C(CF,)CF=CF,)、(3)主鎖から分岐したパーフロロメチ ル基CF, -を有する二重結合を二つ持つ化合物(例えば、 $CF_1 = C(CF_3)CF = CF_2$, $CF_2 = C(CF_3)C(CF_3) = CF_2$, $CF_2 = CFCF$ $(CF_3)CF=CF_2 \cdot CF_2 = CFCF_2 \cdot C(CF_3) = CF_2 \cdot CF_2 = CFCF=C(CF_3) = CF_2 \cdot CF_2 = C$ F₃)、及び、(4)パーフロロメチル基CF₃ -よりも大き い基を有する二重結合を二つ持つ化合物(例えば、CF,C F, CF=CFCF=CF, , CF, =C(CF, CF,)CF=CF,) からなる群から 選ばれる少なくとも1種以上のガスを含む成膜ガスを含

【0009】さらにまた、本発明において、好ましくは 一般式(4):

 $CF, C \equiv CZ$ (4)

(ZはF, I, HまたはG, F, H, (i=1-4、j=0-9、k=0-9、j +k=2i+1)を示す。) で表される化合物を少なくとも1種 以上のガスを含む成膜ガス、特に好ましくは、CF₃C≡CC F, , CF,C≡CF , CF,C≡CCF,CF,を少なくとも1種以上 のガスを含む成膜ガスである。

【0010】該成膜ガスは、①二重結合を一つ有する分 子構造、②単結合を介して二重結合を二つ有する分子構 50 造、③三重結合を有する分子構造を持つガスに分類でき

20

る。以下にとれらの特徴を述べる。

【0011】二重結合を一つ有する分子構造を持つ成膜ガス、特にCF, CF、CF、部分を有するものは、高密度で平坦なフルオロカーボンポリマー膜を形成する特徴を持っている。

7

【0012】単結合を介して二重結合を二つ有する分子 構造を持つ成膜ガスでは、密度の小さいフルオロカーボ ンポリマー膜を形成する。ただし、CF₃ CF部分を有する とその分膜密度は多少高くなる。

【0013】三重結合を有する分子構造を持つガスでは、CF,C部分に由来する密度が高く平坦な膜の性質とC ≡Cに由来する炭素濃度の大きい硬い膜の両方の性質を 併せ持ったフルオロカーボンポリマー膜を形成する。

【0014】これらの**①**~**②**の3種類の成膜ガスを単独 あるいは混合して使用することにより、表面の粗さや膜 の密度を制御したフルオロカーボンボリマー膜を形成で きる。

【0015】表面の粗さの小さい膜ほど微細なバターンへの埋め込み性が優れている。また、膜密度の制御により比誘電率をコントロールすることもできる。例えば、 ①及び/又は②のガスを使用し微細なパターンへの埋め込み堆積を行った後、②及び又③のガスを使用して密度が小さくて硬い膜を形成する事により、膜質の硬い低誘電率膜を形成する事ができる。これに限らず、用途や形状に応じた成膜が可能である。

【0016】 これらの成膜ガスの特徴の詳細を以下に示す。

【0017】の 二重結合を一つ有する分子構造をもつフルオロカーボン系の成膜ガスでは、プラズマ中で、二重結合が解離しやすい。二重結合の両端に結合していた 30フラグメントからラジカルを生じやすい。このラジカルにより、密度の高い平坦なフルオロカーボンボリマー膜を形成することができる。特に、CF, CF=のような構造を持つ分子、例えば、CF, CF=CFCF, ではc-C, F, よりもフルオロカーボン膜の平坦性も2倍以上向上し、膜密度も1nmあたり1.1倍高い。これらはCF, CFフラグメントと結合力の弱い二重結合で構成する構造の分子から、高分子ラジカルが少なく、CF, CFに由来するラジカルが密度の高い平坦なフルオロカーボンを形成することを意味している。この様に、二重結合を持ち特にCF, CFを有するフル 40オロカーボン系の成膜ガスは、高密度で平坦な膜を形成する特徴を持っている。

【0018】② 単結合を介して二重結合を二つ有する分子構造をもつフルオロカーボン系の成膜ガスでは、分子中の二重結合は安定である。そのため、プラズマ中でも容易に解離せず、プラズマの電子温度を高くする傾向がある。この様なプラズマ中で、例えば、CF₂=CFCF=CF₂、CF₃、CF₃CF=CF-CF₂などの二つの二重結合のいずれかの結合が切れると、ひとつの小さいフラグメントCF₂、CF₃CFは、電子温度が高いため、解離が進行してCF・イオン

を生じやすい。ただし、CF, CFからはCF, も多く発生する。もう一つのフラグメントは二重結合を持っているので安定化し大きなフラグメントのまま存在しやすい。例えば、CF2=CFCF=CF2では左右対称な二重結合なのでCF, とCFCF=CF, に解離し、CF, CF=CFCF=CF, は非対称であるので、CF, CF=CFCFとCF, あるいはCF, CFとCFCF=CF, に解離する。このとき生じる比較的大きなフラグメントCF, CF=CF CF、CFCF=CF, は、これらに由来する比較的大きな、例えばCF, CF=CFCF、CFCF=CF, のようなラジカルを生じる。これらのラジカルは構造上大きく、成膜中に堆積するフルオロカーボンボリマー膜は立体構造を形成しやすい。そのため堆積したフルオロカーボンポリマー膜は、粗く密度の小さい膜になる。

【0019】とのような知見は、二重結合を二つ有する 成膜ガスを用いたフルオロカーボンボリマー膜の形成の 制御に役立つ。本発明で示した二重結合を二つ有する成 膜ガスの主なものを例に挙げて大きく以下の四つに分類 した。

(1) パーフロロメチル基-CF,を有しない二重結合を二 つ持つ化合物

CF、=CFCF=CF、、CF、=CFCF、CF=CF、, CF、=CFCF、CF、CF=CF、などが例示される。

(2) 二重結合に直接結合したCF, CF部分を有する二重結合を二つ持つ化合物

CF, CF=CFCF=CF, 、CF, CF=CFCF, 、CF, =CFCF, CF=CFCF, 、CF, CF=C(CF,)CF=CF, などが例示される。

(3) 主鎖から分岐したパーフロロメチル基-CF,を有する二重結合を二つ持つ化合物

CF₁ =C(CF₃)CF=CF₄, CF₄ =C(CF₃)=CF₄, CF₄ =CFCF(C) F₃)CF=CF₄、CF₄ =CFCF₄C(CF₃)₄などが例示される。

(4) パーフロロメチル基-CF, よりも大きい基を有する 二重結合を二つ持つ化合物

CF, CF, CF=CFCF=CF, , CF, =C(CF, CF,)CF=CF, などが例示される。

【0020】(1)のパーフロロメチル基-CF,を有しない 二重結合を二つ持つ化合物は、上述のように、CFCF=CF, 由来する高分子ラジカル(骨格の炭素が3個以上のラジカル)による密度の低いフルオロカーボンボリマー膜を形 40 成する。すなわち、分子を大きくし、CF,=CFCF,CF=CF,, CF,=CFCF,CF,CF=CF,を成膜ガスに用いると、フルオロカーボンボリマー膜はさらに密度の低い膜を形成する。 【0021】(2)の二重結合に直接結合したCF,CF部分を有する二重結合を二つ持つ化合物でも、上述のように、 これらのラジカルは構造上大きく、成膜中に堆積するフルオロカーボンボリマー膜は立体構造を形成しやすい。 そのため堆積したフルオロカーボンボリマー膜は、粗く 密度の小さい膜になる。しかし、CF,CFフラグメントからは先に示したように、CF,CFフラグメントに由来する ラジカルにより密度の高いフルオロカーボンボリマー膜

を堆積させる。分子中にCF, CFフラグメントを有する数 により膜密度を制御できる。

【0022】(3)の主鎖から分岐したパーフロロメチル 基-CF,を有する二重結合を二つ持つ化合物では、枝分か れしているので、さらに大きな立体構造をもつラジカル を発生し、より密度の低いフルオロカーボンボリマー膜 を形成する。

【0023】(4)のパーフロロメチル基-CF, よりも大き い基を有する二重結合を二つ持つ化合物では高分子ラジ を形成する。

【0024】③ 三重結合を有する分子構造を持つフル オロカーボン系の成膜ガスでは、特に好ましい該成膜ガ ス、例えば、CF, C≡ CCF, のプラズマでは、CF, * イオンと CF, CおよびC≡Cフラグメントから発生する低分子のラジ カルをそれぞれ多く含んでいる。CF, Cフラグメントから 発生するラジカルは密度の高い平坦なフルオロカーボン ポリマー膜を形成し、C≡Cフラグメントから発生するラ ジカルは炭素成分の多い硬いフルオロカーボンポリマー 膜を形成する。これらのラジカルにより形成されたフル 20 オロカーボンポリマー膜は、密度が高い性質と炭素成分 が多く硬い性質の両方を併せ持った膜となる。

【0025】本発明の成膜ガスにおいて、分子中に水素 (H) やメチル基(-CH,)を含む本発明の成膜ガスは、ブ ラズマ中で発生したHがフッ素FをHFとして除去し、炭素 濃度の髙いフルオロカーボン膜を形成する。また、Hを 含んだガスは分子量が小さいため、ブラズマCVD装置に ガスとして供給しやすい利点もある。Hを含むことによ り、被堆積面との密着性も良くなる。フルオロカーボン 分子中のフッ素が、臭素、ヨウ素などと置換された化合 30 物では、フルオロカーボン分子中のフッ素を、塩素、臭 素、ヨウ素に置換することにより、結合が弱くなるので 高い電子密度と低い電子温度のプラズマを発生しやすく なる。電子密度が高いほどラジカル量が多くなり、電子 温度が低く抑えられると過剰な解離を抑制でき、成膜に 必要なCF、ラジカルや髙分子ラジカルなどを得やすくな る。この様な効果が最も大きいのがヨウ素である。しか し、分子量が大きくなるので、ガスとして供給しにくく ならない程度の量を置換するのが望ましい。この種の置 換は低分子の成膜ガスにおいて有効である。

【0026】本発明の一般式(1):

Rfh=CXY (1)

(式中、Rfh、X、Yは前記に定義されたとおりであ る。)で表される成膜ガスとしては、具体的には、CF,C F=CFCF₃ 、 CF₃ CF=CF₂ 、 CF₃ CF=C(CF₃)₃ 、 CF₃ CF=C(C , F,), CF, CF=C(C, F,), CF, CF=C(CF,)(C, F,), CF, CF=C $(C_1F_5)(C_1F_7)$, $CF_3CF=C(CF_5)(C_2F_5)$, $CF_3CF=CFC_2F_5$, $CF_3CF=CFC_2F_5$, CF=CFC, F, CF, CF=CFC1, CF, CF=CC1CF, CF, CF=CBrC F₃ CF₃ CF=CFBr CF₃ CF=CFICF₃ CF=CICF₃ CF=C

C, F, CF, CF=CCHF, CF, CF, CF=CCHF, C, F, CF, CF=CCHF, C₃ F₇ CF₃ CF=CCH₄ FCF₃ CF₃ CF=CCH₄ FC₂ F₅ CF₃ CF=CCH₄ F C, F, CF, CF=CCH, F, CF, CF=CCH, CF, CF=CCH, C, F, CF=CCH, CF, CF=CCH, CF=CCH, CF, CF=CCH, CF, CF=CCH, CF, CF=CCH, CF=CCH, CF, CF=CCH, CF= CF, CF=CCH, C, F, CF, CF=CCHFCF, F, CF, CF=CCHFCF, CF, C CF, CF=CCHFCF, C, F, CF, CF=CCHFCF, C, F, CF, CF=CCF, CH F_2 、 CF_3 $CF=CCF_2$ CHF_2 CF_3 CF_3 $CF=CCF_2$ CHF_2 C_2 F_3 、 CF_3 CH=C $FCF_1 \setminus CF_2 CH=C(CF_3)_2 \setminus CF_3 CH=C(C_2F_3)_2 \setminus CF_3 CH=C(C_3F_7)$ $_2$, CF_3 $CH=C(CF_3)(C_3F_7)$, CF_3 $CH=C(C_2F_5)(C_3F_7)$, CF_3 CH= $C(CF_3)(C_3F_5)$, $CF_3CH=CFC_3F_5$, $CF_3CH=CFC_3F_7$, $CF_3CH=CF$ カルにより密度は中程度のフルオロカーボンポリマー膜 10 Cl、CF, CH=CClCF, 、CF, CH=CBrCF, 、CF, CH=CFBr、CF, CH= CFI、CF, CH=CICF, 、CF, CH=CH, 、CF, CH=CHF、CF, CH=CHCF , CF, CH=CHC, F, CF, CH=CHC, F, CF, CH=CCHF, CF, CF, $CH=CCHF_2$ C_3 F_5 CF_3 $CH=CCHF_2$ C_4 F_7 CF_3 $CH=CCH_4$ FCF_3 CF_3 CH=CCH, FC, F, CF, CH=CCH, FC, F, CF, CH=CCH, F, CF, CH= CCH, CF, CF, CH=CCH, C, F, CF, CH=CCH, C, F, CF, CH=CCH FCF, F, CF, OH=COHFCF, CF, CF, CH=CCHFCF, C, F, CF, CH= CCHFCF3 C3 F7 CF3 CH=CCF2 CHF2 CF3 CH=CCF2 CHF2 CF3 CF ,CH=CCF, CHF, C, F,、が例示される。本発明の一般式 (2):

(2) $Rf = C(C_d F_{2d+1}) (C_e F_{2e+1})$

(式中、Rf、d、eは前記に定義されたとおりである。) で表される成膜ガスとしては、具体的には、CF, CF=CFCF 3、 CF₃ CF=CF₂、 CF₃ CF=CFC₂ F₅、 CF₃ CF=CFC₃ F₇、 CF₃ CF=C $(CF_3)_2$, $CF_3CF=C(CF_3)(C_2F_3)$, $CF_3CF=C(CF_3)(C_3F_7)$, $CF_3CF=C(CF_3)(C_3F_7)$ $_3$ CF=C(C $_2$ F $_5$) $_2$, CF $_3$ CF=C(C $_2$ F $_5$)(C $_3$ F $_7$), CF $_3$ CF=C(C $_{3}F_{7}$) $_{2}$ 、 $CF_{3}CF=CH_{6}$ 、 $CF_{3}CF=CHF$ 、 $CF_{3}CF=CHG$ C, F, CF, CF=CHC, F, CF, CF=CCH, F, CF, CF=CCH, CF, CF $_3$ CF=CCH $_3$ C $_2$ F $_5$ 、 CF $_3$ CF=CCH $_3$ C $_3$ F $_7$ 、 CF $_3$ CF=CC $_2$ H $_5$ F $_7$ CF $_3$ CF= CC2 H3 CF3 CF=CC2 H3 C2 F3 CF=CC2 H3 C3 F7 CF5 CF= CC, H, F, CF, CF=CC, H, CF, CF=CC, H, C, F, CF=CC, H, C, F, CF, CF=CFC1 CF, CF=CC1CF, CF, CF=CBrCF, CF ,CF=CFBr、CF,CF=CFI、CF,CF=CICF,が例示される本発明 の好ましい成膜ガスとしては、CF,CF=CFCF,、CF,CF=C F_2 , CF_3 $CF=CFC_2$ F_5 , CF_3 $CF=C(CF_3)_2$, CF_3 $CF=C(CF_3)$ (C 2F₅), CF₃CF=C(C₂F₅)₂, CF₃CF=CH₂, CF₃CF=CHF, CF₃CF= CHCF₃ CF₃ CF=CHC₄ F₅ CF₃ CF=CCH₃ F₇ CF₃ CF=CCH₃ CF₃ C F, CF=CCH, C, F, 、CF, CF=CFI、CF, CF=CICF, が例示され

【0027】本発明で使用する分子中に二重結合を二つ 40 有する一般式(3):

GF4H (3)

(式中、f、g hは前記に定義されたとおりである。)で 表される化合物として、具体的には、

(1) パーフロロメチル基-CF,を有しない二重結合を二つ 持つ化合物

 $\mathsf{CF_2} = \! \mathsf{CFCF} = \! \mathsf{CF_2} \;, \quad \mathsf{CF_2} = \! \mathsf{CHCF} = \! \mathsf{CF_2} \;, \quad \mathsf{CHF} = \! \mathsf{CFCF} = \! \mathsf{CF_2} \;, \quad \mathsf{CF_2} = \! \mathsf{CHCH}$

CF₂ =CFCF₂ CF=CF₂ , CF₂ =CHCF₂ CF=CF₂ , CF₂ =CFCHFCF=CF , CF2 = CHCF2 CH=CF2 , CF2 = CFCH2 CF=CF2 , CF2 = CFCF2 CF2 Hz CF3 CF=CHF CF3 CF=CHCF3 CF3 CF=CHC2 F5 CF3 CF=CH SO CF=CF2 , CF2 =CHCF2 CF2 CF=CF2 , CF2 =CFCHFCF2 CH=CF2 ,

CF₂ =CHCHFCF₂ CF=CF₂ , CF₂ =CHCF₂ CF₂ CH=CF₂ , CF₂ =CFC H₄ CF₃ CF=CF₂ , CF₂ =CFCHFCHFCF=CF₂ など、好ましくは、 CF₂ =CFCF=CF₂ 、CF₂ =CFCF₂ CF=CF₂ , CF₂ =CFCF₃ CF=CF₂ が例示される:

11

(2)二重結合に直接結合したCF, CF部分と二重結合二つ持つ化合物

CF, CF=CFCF=CF2, CF3 CF=CHCF=CF2, CF3 GH=CFCF=CF2, CF3 CF=CFCF=CF2, CF3 CF=CFCF=CFCF3, CF3 CF=CFCF=CFCF3, CF3 CF=CFCF3, CF3 CF=CFCF3, CF3 CF=CHCF=CFCF3, CF3 CF=CHCF=CFCF3, CF3 CF=CHCF4=CFC

F3, CF3 CH=CHCF=CFCF3, CF3 CH=CFCF=CHCF3, CF2 =CFCF3 CF=C

FCF3, CF3 =CHCF4 CF=CFCF3, CF3 =CFCHF4 CF=CFCF3 CF2 =CFC

F4 CF=CHCF3, CF4 =CHCF4 CF=CFCF3, CF4 =CFCH4 CF=CFCF3 CF4 = CHCF4 CF=CHCF4, CF4 =CFCHFCF=CHCF3

(3)主鎖から分岐したパーフロロメチル基-CF,を有する 二重結合を二つ持つ化合物

 $CF_2 = C(CF_3)CF = CF_2$, $CF_2 = C(CF_3)CH = CF_2$, $CF_2 = C(CHF_2)CF$ 20 $= CF_2$, $CF_2 = C(CHF_2)CH = CF_2$, $CF_2 = C(CH_2F)CF = CF_2$, $CF_2 = C(CHF_2)C(CF_3) = CF_2$, $CF_2 = C(CHF_2)C(CF_3) = CF_2$, $CF_2 = C(CHF_2)C(CF_3) = CF_2$

(4)パーフロロメチル基-CF₃よりも大きい基を有する二 重結合を二つ持つ化合物

CF, CF, CF=CFCF=CF, 、CF, CF, CF=CHCF=CF, 、CF, CF, CF=CFC
H=CF, 、CF, CF, CF=CHCH=CF, 、CF, CF, CH=CHCF=CF, 、CF, CF

CH=CFCH=CF, 、CF, =C(CF, CF,)CF=CF, 、CF, =C(CF, CF,)CH=
CF, 、CF, =C(CHFCF,)CF=CF, 、CF, =C(CHFCF,)CH=CF, な
ど、好ましくはCF, CF, CF=CFCF=CF, 、CF, =C(CF, CF,)CF=C

F, が例示される。

[0028] 一般式(3) の好ましい化合物において、fは4~7の整数、特に好ましくは4~6である。

【0029】gは1~12の整数、特に好ましくは3~12である。

【0030】hは0**~11**の整数、特に好ましくは0~4で ある。

【0031】本発明において、二重結合を二つ有する好ましい化合物は、炭素数が5以下の

(1)パーフロロメチル基-CF,を有しない二重結合を二つ

持つ化合物

CF₂ =CFCF=CF₂ 、 CF₂ =CHCF=CF₃ 、 CHF=CFCF=CF₃ 、 CF₂ =CHCH =CF₂

CF2 = CFCF2 CF=CF2 , CF2 = CHCF3 CF=CF2 , CF2 = CFCHFCF=CF
2 , CF2 = CHCF3 CH=CF2 , CF3 = CFCH4 CF=CF3 .

(2)二重結合に直接結合したCF,CF部分と二重結合二つ持つ化合物

CF₃CF=CFCF=CF₂、 CF₃CF=CHCF=CF₂、 CF₃CH=CFCF=CF₂、 CF₃CF=CHCH=CF₂、 CF₃CH=CFCH=CF₂、

(3)主鎖から分岐したパーフロロメチル基-CF₃を有する 二重結合を二つ持つ化合物

(1)パーフロロメチル基-CF3を有しない二重結合を二つ 持つ化合物

CF2 = CFCF= CF2 、 CF2 = CFCF2 CF= CF2 ,

(2)二重結合に直接結合したCF, CF部分と二重結合二つ持つ化合物

20 CF, CF=CFCF=CF,

(3)主鎖から分岐したパーフロロメチル基-CF,を有する二重結合を二つ持つ化合物CF, =C(CF,)CF=CF, ,

最も特に好ましくはCF, CF=CFCF=CF, 及び/又はCF, =CFCF=CF, である。

【0032】本発明で使用する他の成膜ガスは、フッ素と炭素で基本骨格を形成し三重結合-C≡C-構造を有しながら、フッ素と炭素以外の原子を含んでも良い化合物の少なくとも1種(以下、「成膜ガス成分」ということがある)を含むものであり好ましくは一般式(4): CF₁C≡CZ (4)

(Zは前記に定義されたとおりである。)で表される化合物の少なくとも1種からなる。好ましい一般式(4)の化合物としては、具体的には、

などが例示される一般式(4)の化合物において、i は1 ~4の整数、好ましくは1~2である。j は0~9の整数、好ましくは0~9の整数、好ましくは0~5である。

【0033】特に好ましい一般式(4)の化合物としては、具体的には、CF,C≡CCF, 、CF,C≡CF, CF,C≡CCF, 50 CF,が例示される

本発明の成膜ガスは、希ガス、不活性ガス、NH,、H, 炭化水素、Q, 含酸素化合物、ハロゲン化合物、HFC(Hy drofluorocarbon)及び二重結合を持つPFC(perfluorocar bon)ガスからなる群から選ばれる少なくとも1種(以 下、「併用ガス成分」ということがある)を混合して使 用することができる。

13

【0034】具体的には、He、Ne、Ar、Xe、Krなどの希 ガス; N, などの不活性ガス; O, ; CO, CO, などの含酸素 化合物ガス; CF, I、CF, CF, I、(CF,), CFI、CF, CF, CF, I、 CF_3Br , CF_3CF_2Br , $(CF_3)_2CFBr$, $CF_3CF_2CF_2Br$, CF_3C1 , C 10 $F_3 \subset F_2 \subset I$, $(CF_3)_2 \subset F \subset I$, $CF_3 \subset F_2 \subset I$, $CF_3 = CF \subset I$, $CF_4 = CF \subset I$ 1、CFz=CFBr、CFz=CIz、CFz=CClz、CFz=CBrzなどからな るハロゲン化合物;及びCH,F,、CHF,、CHF,、CF,CHF,、 HF2 CH3 CH4 F CF3 CF2 CF2 H CF3 CHFCF3 CHF2 CF2 CHF2 C F3 CF2 CH4 F3 CF3 CHFCHF2 CF3 CF3 CHF2 CF2 CH4 F3 CF3 C F2 CH3 CF3 CH4 CHF2 CH4 CF2 CHF2 CH5 CH5 CHFCH3 CF2 = CHF CC HF=CHF、CH₂=CF₂、CH₂=CHF、CF₃CH=CF₂、CF₃CH=CH₄、CH ,CF=CH, などからなるHFC(Hydrofluorocarbon)ガス及 $U' \subset CF_2 = CF_2$, CF_4 , C_2F_6 , C_3F_8 , $C_4F_{10} \subset -C_4F_8$, $C-C_3F_8$ 20 などからなる単結合及び二重結合を持つPFC(perfluoroc arbon)ガスからなる群から選ばれる少なくとも1種以上 の併用ガス成分を成膜ガス成分と混合して使用しても良 61

【0035】He、Ne、Ar、Xe、Krなどの希ガスは、プラズマの電子温度、電子密度を変化させることができ、また、希釈効果もある。この様な希ガスを併用することにより、フルオロカーボンラジカルやフルオロカーボンイオンのバランスをコントロールして、プラズマ成膜の適正な条件を決めることができる。

【0036】N、、H、NH、を併用することで、低誘電率 膜の成膜において良好な成膜形状が得られる。

【0037】炭化水素とHFCは、ブラズマ中で炭素成分が多いなポリマー膜を、堆積させ密着性をを向上させる。

【0038】含酸素化合物は、CO、CO、や(CF₃), C=Oなどのケトンやアセトン、CF₃CFOCF₃などのエポキサイド、CF₃OCF₃などのエーテルのような酸素を含んだ化合物を意味する。これらの酸素化合物やO₃を併用することで、プラズマ中で高分子ラジカルを分解でき、ラジカル量を制 40 御した堆積膜の形成が可能になる。

 なる。電子密度が高いほどイオン密度も高くなりラジカル発生量が増大する。電子温度が低く抑えられると過剰な解離を抑制でき、フルオロカーボンボリマー膜堆積に必要なCF。ラジカルなどを得やすくなる。この様な効果が最も大きいのがヨウ素化合物である。特開平11-340211号公報、Jpn.J.Appl.Rhys. Vol.39 (2000) pp1583-1596などに示されているように、該ヨウ素化合物は低い電子温度のままで電子密度を上げやすい。

【0040】本発明の成膜ガスとして、成膜ガス成分と併用ガス成分からなる混合ガスを使用する場合、通常、成膜ガス成分の少なくとも1種を流量比10%程度以上、併用ガス成分の少なくとも1種を流量比90%程度以下使用する。好ましくは成膜ガス成分の少なくとも1種を流量比20~99%程度、併用ガス成分の少なくとも1種のガスを流量比1~80%程度使用する。好ましい併用ガス成分は、Ar、N、O、CO、CH、C、H、及びCH、F2、CF, CF, Iからなる群から選ばれる少なくとも1種である。

好ましい成膜条件を以下に示す:

*放電電力200~3000W、好ましくは400~2000W;

*バイアス電力0~1000W、好ましくは0~100W;

*圧力100mTorr以下、好ましくは2~50mTorr;

*電子密度10°-10¹°cm-'好ましくは10¹°-10¹°cm

*電子温度2~9eV好ましくは3~7e V

*ウェハー温度-40~100℃、好ましくは-30~50℃。 *チャンバー壁温度-30~300℃、好ましくは、20~200

放電電力とバイアス電力はチャンバーの大きさや電極の大きさで異なる。小口径ウェハー用の誘導結合プラズマ (ICP)CV D装置(チャンバー容積3500cm³)でフルオロカーボンボリマー膜を成膜する際のとれらの好ましい成膜条件は

*放電電力200~1000W、好ましくは300~600W * バイアス電力0-500W、好ましくは0~100Wである。 【0041】なお、ウェハーが大口径化するとこれらの 値も大きくなる。

[0042]本発明の成膜ガスを用いて成膜する場合、好ましい膜表面粗さRaは $0.1\sim10$ nm、好ましくは $0.1\sim4$ nm;好ましい膜密度は $1\sim4$ a.u.、好ましくは $2\sim3$ a.u.;好ましい膜堆積速度は $200\sim2000$ nm/min、好ましくは $200\sim1000$ nm/minである。

[0043]

.C

30

【発明の効果】該成膜ガスは、①二重結合をひとつ有する分子構造、②単結合を介して二重結合を二つ有する分子構造、③三重結合を有する分子構造を持つガスに分類できる。以下にこれらの特徴を述べる。二重結合をひとつ有する分子構造持つ成膜ガス、特にCF、CF、フラグメント有するものは、高密度で平坦なフルオロカーボンボリマー膜を形成する特徴を持っている。単結合を介して二重結合を二つ有する分子構造持つ成膜ガスでは密度

の小さいフルオロカーボンポリマー膜を形成する。ただし、CF, CF部分を有するとその分膜密度は多少高くなる。三重結合を有する分子構造を持つガスでは、CF, Cフラグメントに由来する密度が高く平坦な膜とC≡Cに由来する炭素濃度の硬い膜の両方の性質を混ぜ合わせたフルオロカーボンポリマー膜を形成する。

[0044] これらの**①~③**の3種類の成膜ガスを単独 あるいは混合で使用することにより、表面の粗さや膜の 密度を制御したフルオロカーボンポリマー膜を形成でき る。とれらの成膜ガスの特徴の詳細を以下に示す。本発 10 明の成膜ガスにおいて、分子中に水素Hやメチル基(-CH 3)を含む本発明の成膜ガスは、ブラズマ中で発生したH がフッ素FをHFとして除去し、炭素濃度の高いフルオロ カーボン膜を形成する。また、Hを含んだガスは分子量 が小さいため、プラズマCVD装置にガスとして供給しや すい利点もある。Hを含むことにより、被堆積面との密 着性も良くなる。フルオロカーボン分子中のフッ素が、 臭素、ヨウ素などと置換された化合物では、フルオロカ ーボン分子中のフッ素を、塩素、臭素、ヨウ素に置換す ることにより、結合が弱くなるので高い電子密度と低い 20 電子温度のプラズマを発生しやすくなる。電子密度が高 いほどラジカル量が多くなり、電子温度が低く抑えられ ると過剰な解離を抑制でき、成膜に必要なCF、ラジカル や高分子ラジカルなどを得やすくなる。この様な効果が米

* 最も大きいのがヨウ素である。しかし、分子量が大きくなるので、ガスとして供給しにくくならない程度の量を 置換するのが望ましい。この種の置換は低分子の成膜ガスにおいて有効である。

16

[0045]

【実施例】以下、本発明を実施例を用いてより詳細に説明する。

実施例1

実際に誘導結合プラズマ(ICP)において、ICP放電電力60 OW,圧力3mTorr、電子密度8×10¹°-2×10¹¹cm⁻³、電子温度5-7eVの成膜条件で堆積させたフルオロカーボンポリマー膜の表面粗さRa(平均面からの偏差nm)と密度をAFMおよびFT-IRで測定した。表1に、これらの測定結果をc-C,F,およびC,F。(構造CF,CF=CF,)の結果と比較して示した。 FT-IRの吸光度はSEMで測定したそれぞれのフルオロカーボン膜の膜厚で規格化した。この値(任意単位、a.u.(arbitrary unit))は膜厚10Å(10原子層以下)中の結合数の比を示しており、これを膜密度として見積もることができる。また、表1にはプラズマ中のCF、(x=1-3)ラジカル量とフルオロカーボンボリマー膜の堆積速度も示した。

[0046]

【表1】

	CF	CF ₂	CF,	膜接面観さ	膜密皮	膜堆積速度
	(×10 ¹¹ cm²)		Re(nm)	(a.u.)	(nm/min)	
o-C₄F₁	5.5	15	50	1.8	2.3	259
CF,CF=CFCF,	3.5	6	40	0.8	2.5	285
CF,CF=CF,	2.5	6	25	1.4	2.4	243
CF ₂ =CFCF=CF ₂	2	3	8	2.8	1.7	282
CF_CF=CFCF=CF,	3	9	30	6.1	1.9	317

【0047】CF, =CFCF=CF, 、CF, CF=CFCF=CF, のガスプラ ズマではCF'イオンの比率が高い。CF, CF=CFCF=CF, がCF, CFフラグメントを有しているためCF, =CFCF=CF, よりもCF , *を発生しやすく、CF, CFフラグメントに由来するラジ カルにより密度の高いフルオロカーボンポリマー膜を堆 積させる。同じCF, CF=CF, よりCF, *が少ないことから、C※ ※ F, CF=CFCF=CF, はCF, CF=CFCFとCF, に優先的に開裂している。また、これらのガスプラズマで形成されるフルオロカーボンポリマー膜は密度が小さく、粗い表面を有し、膜堆積速度も大きい。CF, CF=CFF、CFCF=CF, に由来する高分子ラジカルが多いことを示している。

フロントページの続き

(72)発明者 青山 博一

大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン 工業株式会社淀川製作所内 Fターム(参考) 4K030 AA04 AA11 BA35 FA04 LA02 LA18 5F058 AA10 AC10 AF02 AH02 AH03